

地域	関東(東京都)	事業分野	製造(電子機器)	認定日	平成17年7月8日
----	---------	------	----------	-----	-----------

テーマ名: 三次元多積層電子モジュール

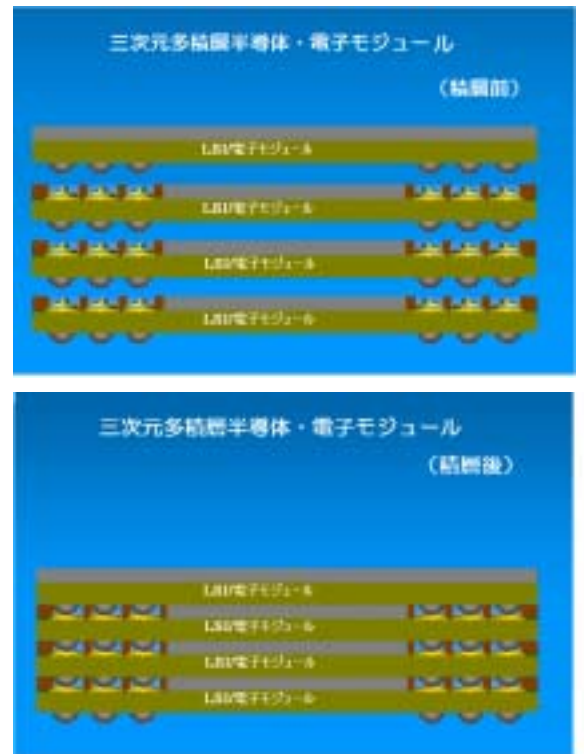
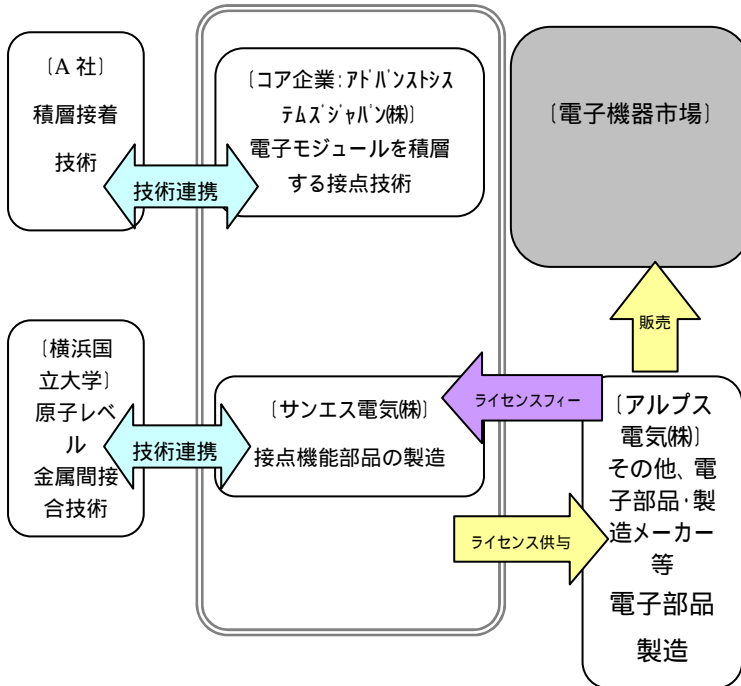
事業計画の概要:

- ・ソケット機能を備えた半導体及び電子部品、電子回路基板の開発、事業化
- ・半導体及び電子部品の電子回路基板にマイクロ接点を実装する技術の開発と3次元積層パッケージの積層技術及び放熱技術の開発、事業化
- ・MEMS(Micro Elector Mechanical Systems)製法で作られたマイクロ接点パネを半導体及び電子部品の電子回路基板に原子レベル圧着溶接(金属融合)する高信頼組立実装技術の開発
- ・コア企業の「マイクロ接点技術」を活用し、デジタル家電市場等における電子機器の小型化、高機能化ニーズに応えるもの

コア企業: (株)アドバンスシステムズジャパン(三鷹市:半導体製造装置製造業)

連携企業等: サンエス電気(株)、横浜国立大学工学研究院機器分析評価センター

連携体の構成



連携の特徴

コア企業の理論を連携企業がノウハウを持って実現し、要素技術を具現化。さらに事業化に向けて、大学との連携により製品化を達成する。

新事業

小型化、高機能化する市場ニーズを捉えるもの。

市場性

全ての電子機器が本技術の応用展開分野
大手電機・半導体メーカーからも引き合いが来ている。

支援予定メニュー

市場化・事業家支援補助金 設備投資減税